

トピックス

第5回先端電子材料 EXPO ～マテリアルジャパン～ 出展

開催日時；2014年1月15日～17日

開催場所；東京ビッグサイト

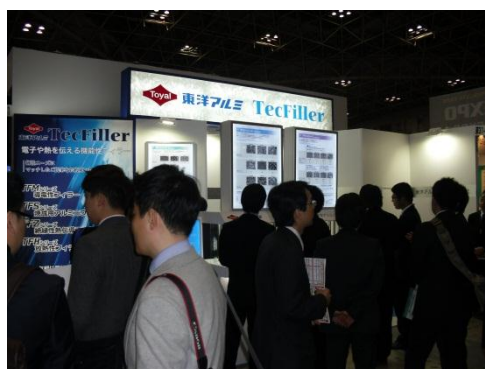
コアテクノロジーセンター
研究開発室（平野）

南山 偉明

エレクトロニクス関係が一堂に集まるネプコンジャパン 2014 が東京ビッグサイトで開催され、その中の先端電子材料 EXPO に、東洋アルミが初出展し、機能性フィラー“TOYAL TecFiller™”の4シリーズ（めっき導電性フィラー“TFM シリーズ”、導電性アルミニウムフィラー“TFS シリーズ”、熱伝導アルミニウムフィラー“TFH シリーズ”、窒化アルミニウムフィラー“TFZ シリーズ”）、ブレージングペーストおよびダミーボールの6品種を展示しました。

先端電子材料 EXPO としては初めての出展で来場者の関心を寄せる事が出来るか心配でしたが、当社のブースに3日間で600名を超えるお客様が来られ、対応に追われるほど盛況でした。

特に、熱伝導性絶縁材料（窒化アルミニウムフィラー）のTFZシリーズは、時代のニーズに乗り、めっき導電性フィラーのTFMシリーズは、その技術力に初めて知るお客様が驚きと関心を示され、共に大きな反響を得て問合せも多く、今後の展開が期待されます。



東洋アルミの展示会場

第5回[国際]二次電池展 ～バッテリージャパン～ 出展

開催日時；2014年2月26日～28日

開催場所；東京ビッグサイト

コアテクノロジーセンター

研究開発室

村松 賢治

最先端の蓄電デバイス及びその部材、関連技術が紹介される[国際]二次電池展が東京ビッグサイトで開催された。東洋アルミも東海東洋アルミ販売として出展し、貫通孔アルミニウム箔「トーヤルパス®」や電気二重層キャパシタ用の低抵抗集電体「EDLC用トーヤルカーボ®」など電極部材を展示した。ブース訪問客の半数近くは海外からの来場者であり、展示会に対する国内外からの関心の高さが伺えた。「トーヤルパス®」の微細な貫通孔形成や「EDLC用トーヤルカーボ®」のバインダ無しでのカーボン固着は東洋アルミ固有の技術であり、多くの方が興味を示されていた。本来、「トーヤルパス®」はリチウムイオンキャパシタの正極集電体として開発されたが、リチウムイオン電池としても引き合いが多く、より大きな市場への展開が期待できる。



東海東洋アルミ販売の展示ブース



前の紹介へ



次の紹介へ



お問い合わせ